

### Dip&Print Station für ERSA Rework Systeme

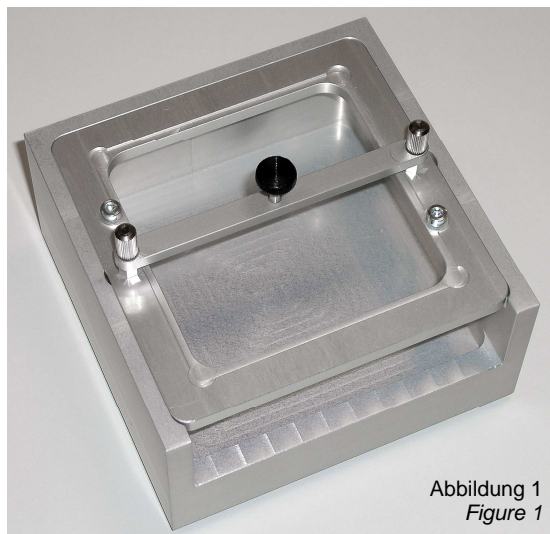


Abbildung 1  
Figure 1

Die ERSA **Dip&Print Station** (Abb. 1) ermöglicht dem Anwender von ERSA Rework Systemen die Bauteilvorbereitung (Auftrag von Lotpaste oder Flussmittel) einfach, zuverlässig und reproduzierbar vorzunehmen.

Optionale **Dip-Schablonen** (Abb. 2) erlauben es, Bauteile definiert in Flussmittel oder Lotpaste einzutauchen und so ein definiertes Depot an den Lötanschlüssen zu erzeugen. Dieses Verfahren eignet sich für BGA und die meisten Fine-Pitch Bauteile. Mit einer bauteilspezifischen **Print-Schablone** werden z.B. QFN / MLF Anschlüsse und die anderer SMD Komponenten einfach und präzise mit einem Lotpastendepot versehen.

Beim Print-Prozess wird das in die Schablone eingespannte Bauteil von unten mit Lotpaste bedruckt, um anschließend mittels der Platziereinheit aus der Schablone ausgehoben und platziert zu werden.

Für jedes ERSA Rework System gibt es eine passende Rahmenfixierung zur Aufnahme des Schablonenrahmens der Dip&Print Station am Platziersystem.

Funktionsweise auch auf [www.ersa.de](http://www.ersa.de)

### Dip&Print Station for ERSA Rework Systems

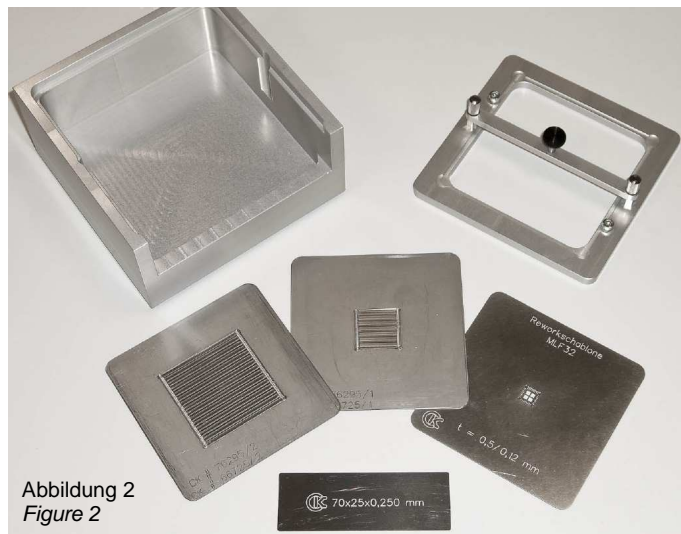


Abbildung 2  
Figure 2

*The ERSA **Dip&Print Station** (fig. 1) enables effective preparation of multiple component body types before rework. Fluxes or solder pastes can be applied to the solder connections precisely, reproducibly and very easy in handling.*

*Optional **Dip-in stencils** (fig. 2) allow for easy flux or solder paste dipping. This process is suitable for many BGA and fine-pitch type SMD components. The component connections are simply dipped into a defined reservoir of flux gel or solder paste. Using a component specific **print-stencil** for a given SMD, e.g. QFN / MLF types and others can be printed very easily with a precise solder paste amount.*

*In the printing process the component is fixed to the stencil and printed with solder paste on its bottom side. After flipping it back, the part is positioned on the PCB with the placement unit.*

*For every ERSA Rework System there are adequate frame fixtures to attach the stencil frame of the Dip&Print station to the placement unit.*

*See operation also on [www.ersa.com](http://www.ersa.com)*

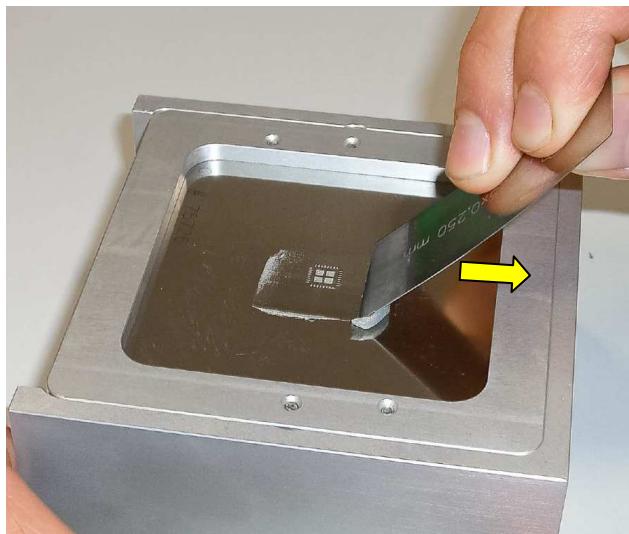


Abbildung 3 Bedrucken eines MLF mit Lotpaste  
Figure 3 paste printing of an MLF component

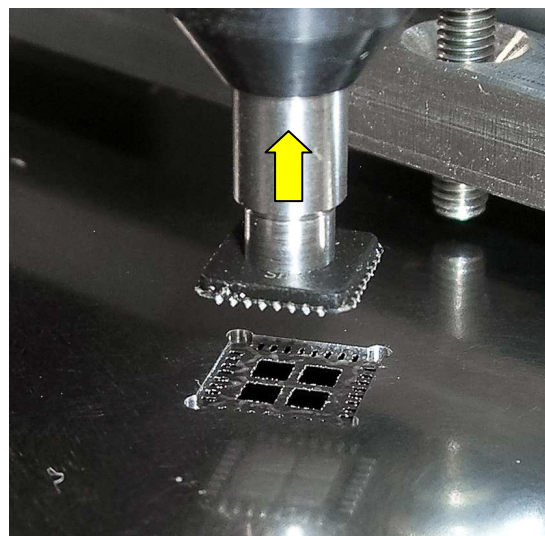


Abbildung 4 Ausheben des MLF mit PL 650  
Figure 4 lifting of MLF component with PL 650

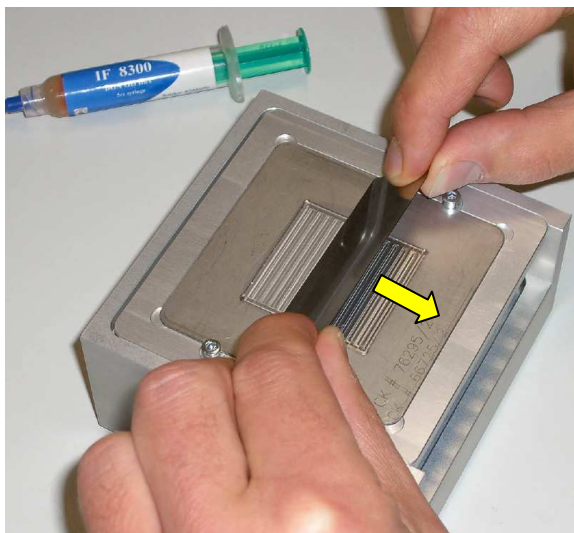


Abbildung 5 Vorbereiten einer Dip-Schablone mit Flussmittel  
Figure 5 preparation of a dip stencil with flux

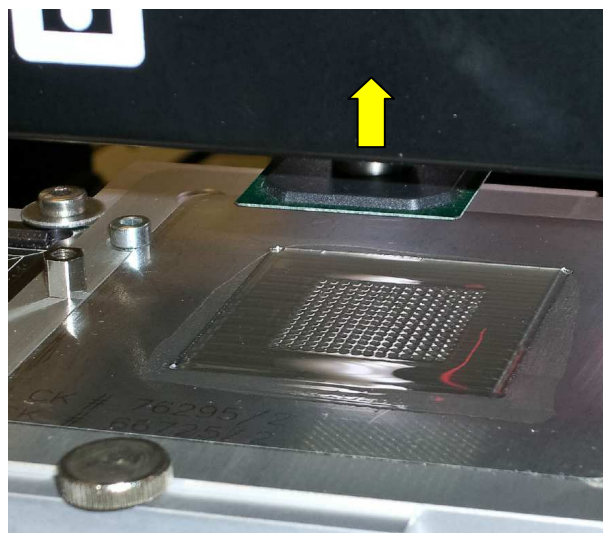


Abbildung 5 Flux-Dip eines BGA 225 an PL 550  
Figure 5 flux-dip of BGA 225 on PL 550

**Technische Daten:**

Abmessungen (LxBxH) 105x105x55 mm  
Material Aluminium/Edelstahl

**Bestellinformation:**

**OPR100** Dip & Print Station komplett  
**OPR100-D001** Dip-Schablone 40 x 40 mm  
**OPR100-D002** Dip-Schablone 20 x 20 mm  
**OPR100-S001** Schablone BGA 225  
**OPR100-S002** Schablone MLF 32  
**OPR100-PL550** Rahmenfixierung für PL 550  
**OPR100-PL650** Rahmenfixierung für PL 650

**Hinweis:**

Weitere Dip&Print Schablonen auf Anfrage.  
Bitte geben Sie Maße und Bauteilform an.

**ERSA GmbH**

**Technical Data:**

Dimensions (LxWxH) 105x105x55 mm  
Material aluminium/stainless steel

**Ordering information:**

**OPR100** Dip & Print Station complete  
**OPR100-D001** Dip-stencil 40 x 40 mm  
**OPR100-D002** Dip-stencil 20 x 20 mm  
**OPR100-S001** Stencil BGA 225  
**OPR100-S002** Stencil MLF 32  
**OPR100-PL550** Frame fixture for PL 650  
**OPR100-PL650** Frame fixture for PL 650

**Note:**

Other Dip&Print stencils upon request.  
Please state component dimensions.

A **Kurtz** Company